

製品ポートフォリオと機能紹介

パッケージ名 & メッシュ種類

●：標準機能 | ○：オプション

メッシュ	パッケージ名	eDesign Basic	eDesign	Professional	Advanced
eDesign		●	●	●	●
Designer BLM (Boundary Layer Mesh, Tetra)				●	●
Solid (Hexa, Prism, Pyramid, Hybrid, Tetra)				○	●
Shell					●

標準的な射出成形

●：標準機能 | ○：オプション

	eDesign Basic	eDesign	Professional	Advanced
ソルバー能力				
同時流動解析 (最大値)	1	1	1	3
並列計算 (PP)	4	4	8	12
熱可塑性樹脂射出成形	●	●	●	●
熱硬化性樹脂射出成形	●	●	●	●
シミュレーション機能				
充填	●	●	●	●
表面欠陥予測	●	●	●	●
エアレント解析	●	●	●	●
ゲート位置アドバイザー	●	●	●	●
コールド&ホットランナー	●	●	●	●
ランナーバランス	●	●	●	●
保圧		●	●	●
冷却		●	●	●
非定常冷却・加熱		●	●	●
コンフォーマル冷却		●	●	●
3D冷却CFD解析		○	●	●
高速金型表面温度制御 (Heat & Coolなど)		●	●	●
ヒーターエレメント (PID制御)		●	●	●
そり変形		●	●	●
インサート成形		●	●	●
2色成形		●	●	●

Solution Add-on

●：標準機能 | ○：オプション

	eDesign Basic	eDesign	Professional	Advanced
統合CAD				
SYNC	○	○	○	○
Moldex3D CADdoctor			○	○
Moldex3D Cooling Channel Designer (CCD)		○	○	○
繊維強化プラスチック				
繊維配向解析	○	○	○	○
応力解析		○	○	○
FEA インターフェイス		○	○	○
Micromechanics インターフェイス		○	○	○
Moldex3D Digimat-RP		○	○	○
最適化 (DOE)				
エキスパート (Expert)		○	○	○
熱管理				
アドバンスドホットランナー		○	○	○
インモールド成形			○	○
光学				
光学特性解析				○
粘弾性 (VE)				
残留応力解析		○	○	○
特殊成形工程				
粉末射出成形 (PIM)	○	○	○	○
射出発泡成形 (物理発泡 MuCell® 等/化学発泡)		○	○	○
ガスアシスト射出成形 (GAIM)			○	○
ウォーターアシスト射出成形 (WAIM)			○	○
サンドイッチ成形			○	○
バイインジェクション成形			○	○
PU 化学発泡成形			○	○
圧縮成形 (CM)				○
射出圧縮成形 (ICM)				○
RTM (Resin Transfer Molding)				○

- Moldex3D SYNCは、PTC® Creo®, NX, SOLIDWORKS®をサポートしています。
- Moldex3D FEAインターフェイスは、Abaqus, ANSYS, MSC.Nastran, NE Nastran, NX Nastran, LS-DYNA, Marc, OptiStructに対応しています。
- Moldex3D Micromechanicsインターフェイスは、Digimat, Converseに対応しています。
- データベース：熱可塑性材料、熱硬化性材料、成形機、冷却材料、金型材料。
- ICパッケージングモジュールは別パッケージとなります。
- MuCell®は、Trexel Inc.の登録商標です。

推奨システム構成

- Microsoft Windows 10, 8, 7, Server 2012, 2008, HPC Server 2008
- Intel® Xeon® E5 プロセッサ, 32GB以上のRAM, 2TB以上の空き領域